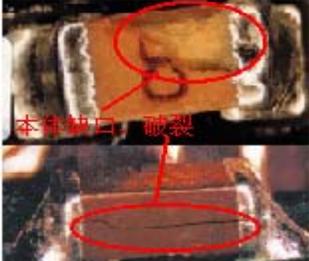
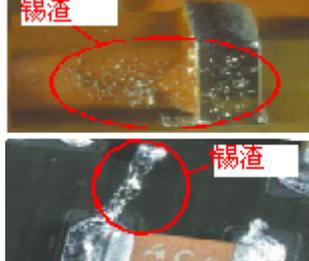
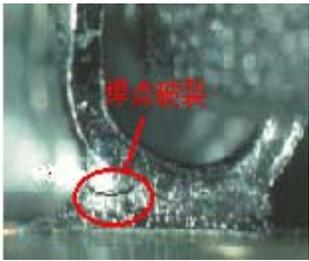
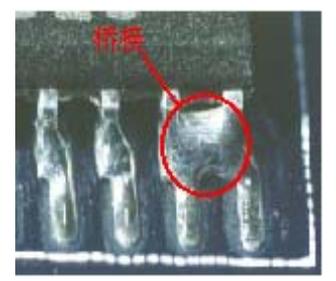
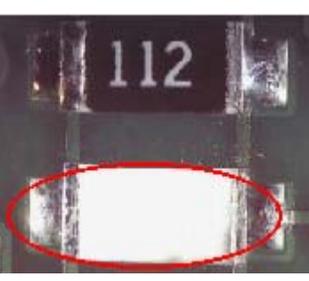
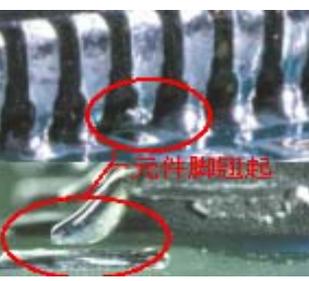
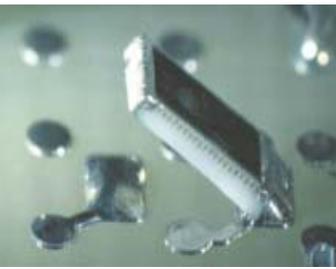
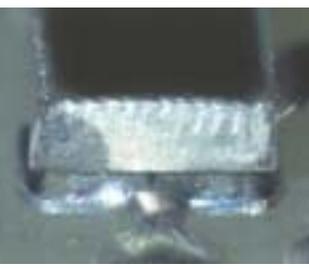
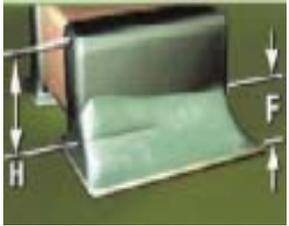
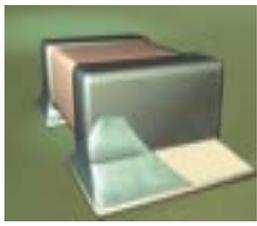
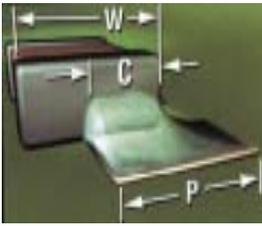
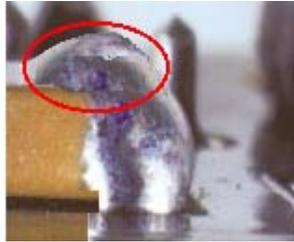
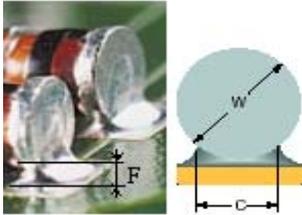
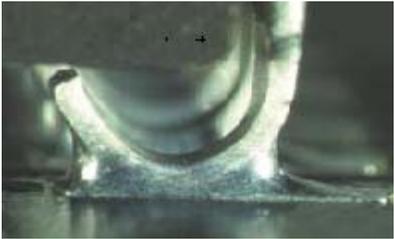
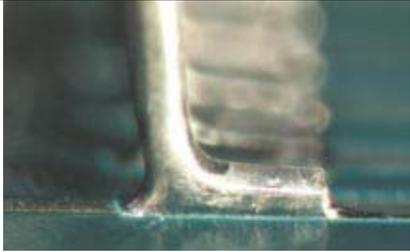
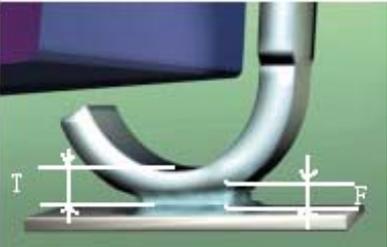
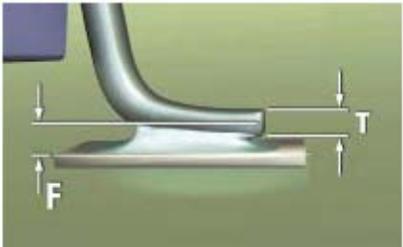
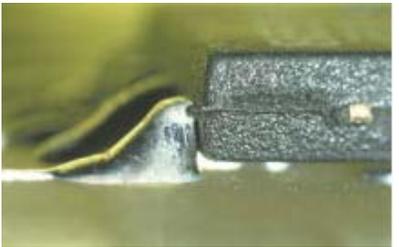


SMT 工艺标准

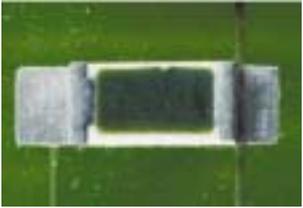
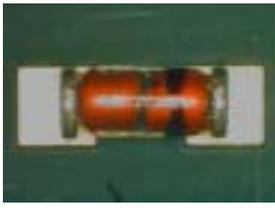
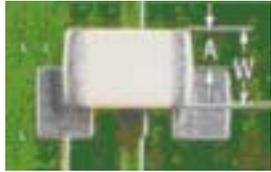
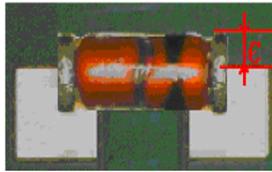
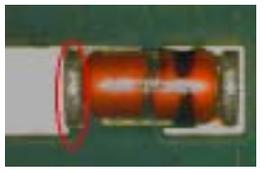
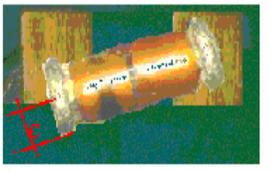
版次	1.0	机型	通用	名称	焊接检查	拟制		
						批准		
1.不良缺陷								
缺陷类型	焊盘脱落	锡珠	元件破损	锡渣	锡裂			
不良缺陷图示								
缺陷定义	焊盘与基材之间有分离。	目视可见元件本体、焊端、引脚旁有焊料球	目视可见元件本体有裂口或裂缝，元件的金属镀层剥落	目视可见元件本体或周围有焊锡渣	目视可见焊点有裂口或裂缝			
缺陷类型	针孔/吹孔	连焊	翻片	翘脚	侧立			
不良缺陷图示								
缺陷定义	目视可见焊点上有较大的孔洞	焊锡在毗邻的不同导线或元件间形成桥连	元件贴装颠倒	元件引脚不共面,个别脚未与焊盘接触焊接	片式元件侧面翘起。			
缺陷类型	极性反	墓碑	冷焊	锡尖	不浸润（漏焊）			
不良缺陷图示								
缺陷定义	元件的极性接反	片式元件立起或末端翘起。	焊锡未完全熔化，焊点表面粗糙无光泽	目视可见焊点上有焊锡拉尖	焊锡未浸润焊盘或元件焊端			

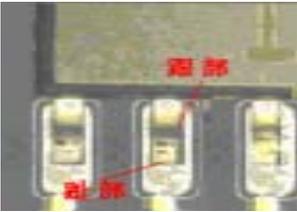
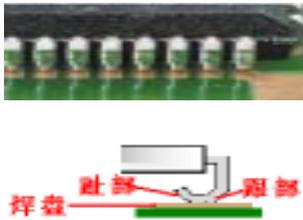
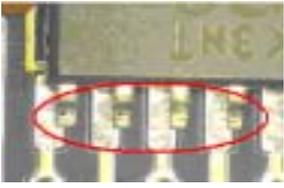
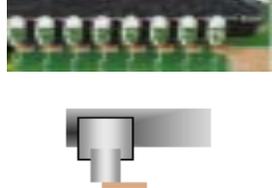
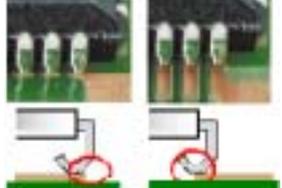
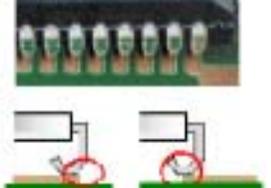
版次	1.0	机型	通用	名称	焊接后检查	批准		
2. 焊点形状								
元件类型		片式元件 (CHIP)			MELF			
示意图	标准							
	拒收							
拒收判定基准	焊点的高度(F)小于 1/3 元件焊端高度(H),判为少锡	焊料未充分浸润或元件偏移,焊点宽度(C)小于 1/4 元件焊端宽度(W)或焊盘宽度,判为少锡		焊料过分凸起并接触到元件本体	焊点高度(F)或宽度(C)小于 1/3 焊端直径(W),判为少锡	焊料过分凸起并接触到元件本体		
元件类型		J形引脚 (SOJ/PLCC/LCCC/网络电阻)			扁平、L形、翼形引脚元件 (SOT/SOP/QFP 等)			
示意图	标准							
	拒收							
拒收判定基准	焊点的高度(F)小于 2/3 元件厚度(T),判为少锡	焊料过分凸起并接触到元件本体,判为多锡		焊点的高度(F)小于 2/3 元件厚度(T),判为少锡	焊料过分凸起并接触到元件本体,判为多锡			

SMT 工艺标准

版次	1.0	机型	通用	名称	焊接后检查	拟制			
						批准			

3.元件位置

元件类型		CHIP			MELF		
示意图	标准						
	拒收						
拒收判定基准		有纵向偏移, 偏离量超焊盘宽度的 1/4	旋转偏移, 偏离量超焊盘宽度的 1/4	横向偏移, 焊端未完全在焊盘上	有纵向偏移, 偏离量 C 超元件直径的 1/5	横向偏移, 焊端未完全在焊盘上	有旋转偏移, 偏离量 C 超元件直径的 1/5

元件类型		扁平、L 形、翼形引脚元件 (SOT/SOP/QFP 等)			J 形引脚 (SOJ/PLCC/LCCC/网络电阻)		
示意图	标准						
	拒收						
拒收判定基准		横向偏移, 1/3 的引脚宽度偏离焊盘	纵向偏移, 引脚的跟部或趾部在焊盘边缘或偏离焊盘	旋转偏移, 引脚的跟部或趾部在焊盘边缘或偏离焊盘	少量旋转偏移, 但偏转后两元件焊端接触在一起	横向偏移, 焊端未完全在焊盘上	横向偏移, 1/3 的引脚宽度偏离焊盘